

# 株主通信



三井金属

## Contents

- |    |                  |    |                            |
|----|------------------|----|----------------------------|
| 01 | トップメッセージ         | 05 | なるほど！三井金属                  |
| 02 | 財務ハイライト          |    | ・三井金属グループのパーパス             |
| 02 | セグメント別業績の概況      |    | ・薄型基板内蔵キャパシタ材料「FaradFlex®」 |
| 03 | Special Report   | 07 | 会社概要                       |
|    | ・新技術への果敢な挑戦で     | 07 | 株式の状況                      |
|    | “未来”に貢献する「機能性粉体」 | 07 | 株主メモ                       |
|    |                  | 07 | 役員                         |

第98期  
上半期報告書

2022年

4月1日

2022年

9月30日

証券コード：5706



## 持続的な 企業価値の向上に 取り組んでまいります

株主の皆様には日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。第98期上半期が終了しましたので、ご報告申しあげます。当期間においては前年同期に比べ、亜鉛相場は上昇、為替相場も円安が進行し、当社グループの売上高は前年同期比371億円増加の3,423億円となりました。経常利益は、エネルギーコストの上昇や前年同期に計上していた棚卸在庫要因の剥落の影響などから、前年同期比35億円減少の340億円となりました。下半期は、エネルギーコストの上昇や製錬所の大規模定期修繕などの影響により、上半期より収益は悪化する見込みですが、引き続き全社を挙げて持続的な企業価値の向上に取り組んでまいります。今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申しあげます。

代表取締役社長 のう たけし 納 武士

上半期トピックス **2022** 上半期(2022年4月1日~2022年9月30日)の主な取組みについてご紹介します。

7月

### 薄型基板内蔵キャパシタ材料の 生産能力増強およびBCP体制構築

銅箔事業部が生産している薄型基板内蔵キャパシタ材料「FaradFlex®(ファラドフレックス)」について、マレーシア工場での生産能力増強、および上尾事業所(埼玉県)での生産設備の新規導入を決定しました。マレーシアおよび上尾の2拠点生産体制で、現在の約2.2倍の生産量となります。FaradFlex®については、本株主通信の「なるほど!三井金属」でも紹介していますので、ぜひご覧ください。

➡ 詳細は2022年7月28日発表のリリースをご覧ください。

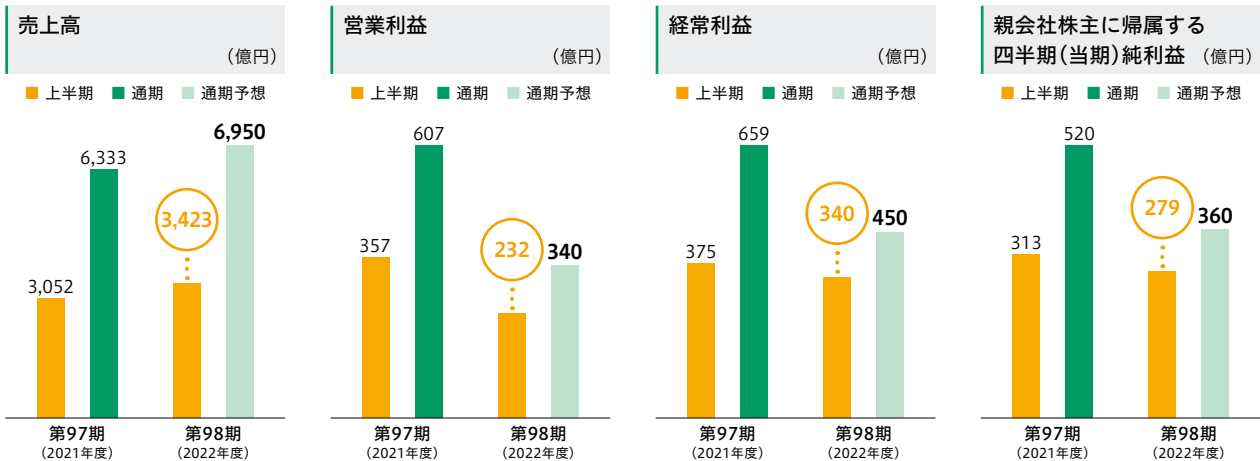
7月

### 環境エネルギー領域ベンチャー イーセップ株式会社への出資

コーポレート・ベンチャーキャピタルを通じた8社目の投資活動として、セラミック製の機能性分離膜を手がけるイーセップ株式会社に出資しました。イーセップの分離膜技術と当社が得意とする無機材料技術との融合により、e-fuel製造用メンブレンリアクターの開発等、カーボンニュートラル社会の実現に貢献する環境エネルギー分野での事業機会を広く追求していきます。

➡ 詳細は2022年7月28日発表のリリースをご覧ください。

## 財務ハイライト



※ 通期予想につきましては、2022年11月9日現在において入手可能な情報に基づき作成したものでありますので、実際の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。

## セグメント別業績の概況

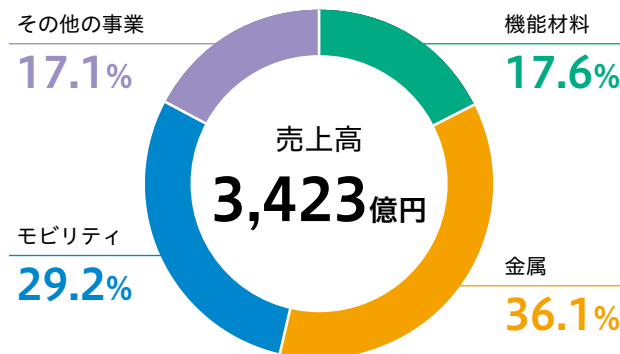
※ 2022年4月1日付の全社的な組織改編に伴い、事業セグメントを変更しています。

機能材料セグメントは、電子材料市況の悪化を受け、キャリア付極薄銅箔やスパッタリングターゲットの需要が低調に推移し、販売量が減少したことから、売上高、経常利益ともに減少。

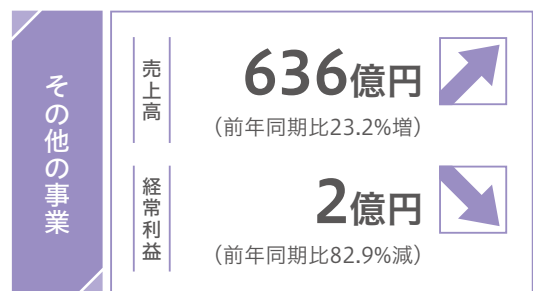
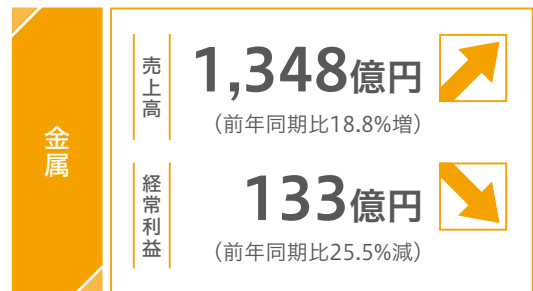
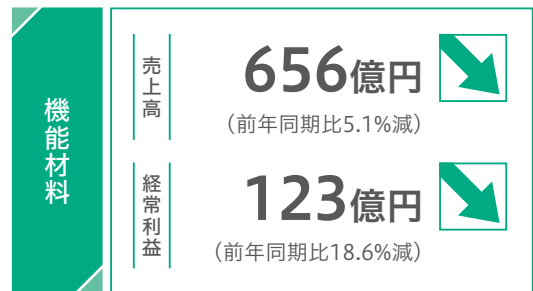
金属セグメントは、亜鉛のLME(ロンドン金属取引所)の平均価格が上昇したことから、売上高は増加。LME価格の上昇や円安の影響による増益要因があったものの、エネルギーコストの上昇や非鉄金属相場の変動に伴う在庫要因の影響等により、経常利益は減少。

モビリティセグメントは、排ガス浄化触媒やサイドドアラッチの販売量が増加。排ガス浄化触媒の主要原料であるロジウム価格等の変動に伴う影響に加え、鋼材および樹脂価格上昇による減益要因があったものの、為替差益が増加したことにより、経常利益は増加。

その他の事業セグメントは、亜鉛のLME価格上昇や円安の影響等により、売上高は増加したものの、持分法による投資損益が悪化したことから、経常利益は減少。



※ 各セグメントの売上高および経常利益はセグメント間の内部売上高または振替高を含んでいます。



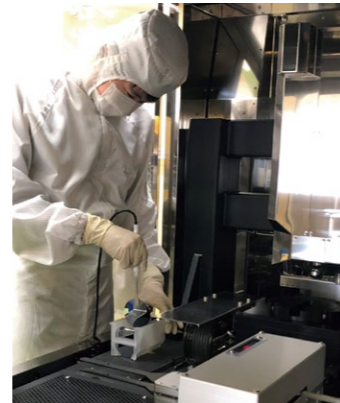
# 新技術への果敢な挑戦で “未来”に貢献する「機能性粉体」



機能性粉体事業部では、長年の開発・製造により蓄積した豊富なノウハウと粉体制御技術を駆使した各種高機能粉末を提供しています。スマートフォンの高機能化や自動車の電装化など各種電子デバイスの高機能化を支える銅粉・銀粉・半田粉、ディスプレイの大型化のニーズに応える研磨材、低炭素社会に貢献するハイブリッド車に搭載されるニッケル水素電池用水素吸蔵合金など多数の製品をラインナップ。長年ご愛顧いただいている製品のさらなる高機能化に加え、複雑造形が可能な3Dプリンター用銅合金粉や、様々な用途展開が期待されるレアメタル溶液など多数の新商品開発にも注力しています。

## コア技術を活かした新たな価値の創造

機能性粉体は、エレクトロニクス分野の多種多様なアプリケーションに幅広く関わっています。これまで様々なニーズへの対応にチャレンジし、技術を磨いてきました。無機材料の組成開発技術・粒子／粉体のカスタマイズ技術、素材のリサイクル技術、そして最近では難溶性材料の溶解技術を新たなコア技術としています。近年、カーボンニュートラル・SDGsを背景に市場のトレンド・ニーズが変化中、機能性粉体事業は大きく飛躍するポテンシャルを秘めています。今後は、サステナブルな材料設計、コア技術の強化、パートナーとの協業を通し、エレクトロニクス分野の深化および未踏新分野への参入を目指します。



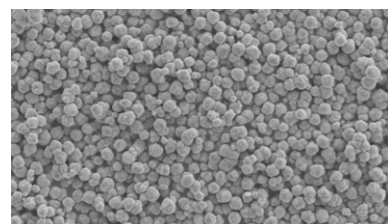
### 既存製品

#### 電子材料用銅粉

世界シェア **No.1**

三井金属の電子材料用銅粉はシェア30%を占める世界No.1の商品です。複数の製法(アトマイズ法、湿式合成法、電解析出法 等)を有しており、それぞれの特徴を活かしてお客様の幅広いニーズに応えています。

**用途** 積層セラミックコンデンサ(MLCC)および低温同時焼成セラミックス(LTCC)の電極材料用ペースト、スルーホール用ペースト、導電性接着剤 など



#### 研磨材

世界シェア **No.1**

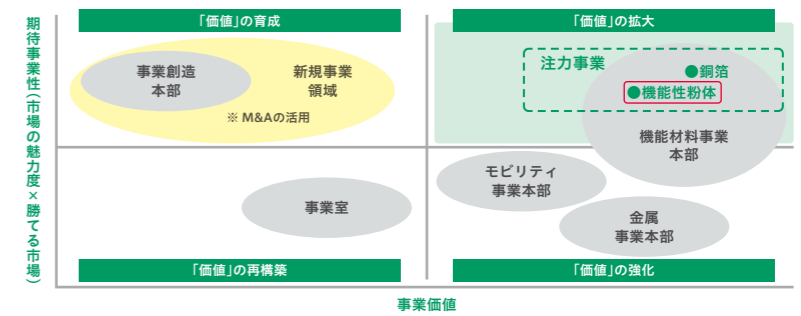
三井金属の研磨材は、液晶ガラス基板の研磨用途で世界シェアNo.1を占めています。ガラスハードディスクの研磨にも新たに採用され、またSiCウェハ研磨向けに開発されたNANOBIXTMの採用が広がるなど、成長が期待されています。

**用途** 液晶ディスプレイ用ガラス基板の研磨、ガラスハードディスクの研磨、パワーデバイス用SiCウェハの研磨 など



## 中期経営計画「22中計」における「機能性粉体事業部」の位置づけ

機能性粉体事業部は、「22中計」における注力事業と位置づけています。新商品、新規事業の継続的創出および既存事業の利益最大化に注力するとともに、経済的価値と社会的価値の向上を両立した、事業価値向上を目指しています。



※ 2022年5月20日発表の「22中計」資料のP.40をご参照ください。 <https://www.mitsui-kinzoku.com/toushi/management/chyukei/>

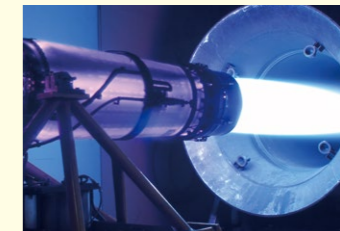
## 開発品 独自技術で新たな市場を拓く開発品

### 3Dプリンター用銅合金粉

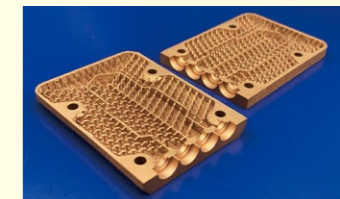
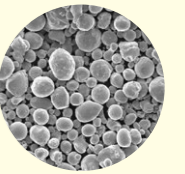
#### 将来の市場成長が期待できる材料

今後、市場拡大が期待される3Dプリンター向けに銅合金粉を展開しています。純銅の95%となる高い導電率と、純銅の3倍以上の高強度の2種類グレードがあり、ともに市場品よりも優れた特性を示しています。これらの特徴を活かして、幅広い顧客ニーズに応えながら、ワールドワイドに市場開拓を進めています。

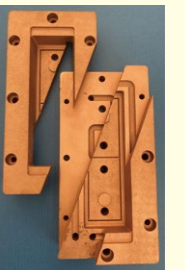
**用途** データセンター向け放熱用ヒートシンク、電気自動車向けモーター周辺部材、衛星向けロケット部材、誘導加熱向けコイル、金型等への展開を目指しています。



ロケットチャンパー使用イメージ



ヒートシンクの断面



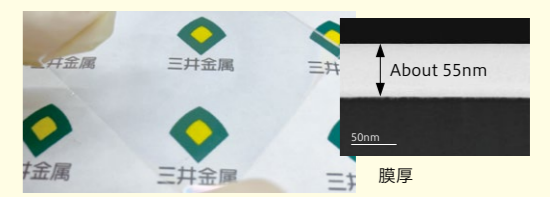
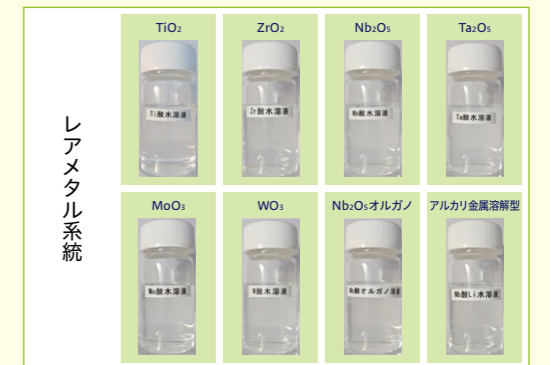
金型の断面

### レアメタル溶液

#### 無機材料市場に大きなインパクトを与える新材料

難溶性であるために用途が限定されてきた、Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>、Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>をはじめとする難溶性元素(TiO<sub>2</sub>、ZrO<sub>2</sub>、WO<sub>3</sub>、MoO<sub>3</sub>等)を、当社独自の溶解技術により市販製品として初めて溶液化することに成功しました。非常に反応性が高く、用途によらず様々な材料複合化に応用可能です。自由度の高さを活かし、オープンイノベーションによる新規市場開拓に力を入れています。

**用途** 電池材料やガラス等へのコーティング、複合材料の原料として展開中。粉体よりも簡便かつ低温で反応するためプロセスが軽減でき、省エネ対策にも有効です。SDGsへ貢献する新材料として事業化を進めます。



ガラスへのコーティング例

➔ その他の製品ラインナップはこちらでご覧いただけます。 <https://www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/kinousei-funtai/>



## 三井金属グループのパーパス



2022年2月に発表した三井金属グループのパーパス。2050年の世界を想定し、「人類への貢献」と「環境への貢献」を両立することが大切であるとの認識のもと、「社会的価値の向上」と「経済的価値の向上」を両立した統合思考経営を実践することで、持続的な企業価値向上の仕組みを構築し、成長し続けるため、判断基軸となる「パーパス」を「探索精神と多様な技術の融合で、地球を笑顔にする。」と設定しました。

### パーパス浸透活動の展開

パーパスをより多くの方に認知・理解していただくため、パーパスのビジュアル、ストーリームービーおよび特設サイトを制作しました。

#### ・ビジュアル

両手で地球を包み込むデザインのメインビジュアルは、よく見ると地球が笑っています。三井金属グループの強みである「探索精神」と「多様な技術の融合」を両手で表現し、環境への貢献と人類への貢献を両立し笑顔になっている地球を、その両手で包み込むようにデザインしました。

#### ・ストーリームービー

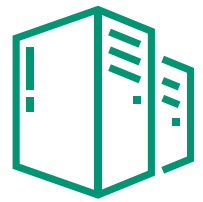
三井金属グループがこれまで培ってきた強みを活かし、パーパスを基軸に持続可能な未来へ挑戦していくことを動画で表現しました。

#### ・特設サイト

パーパスやストーリームービーだけでなく、三井金属グループのパーパスにもとづいた取組みやパーパス活動レポートを掲載しています。また、国内だけでなく海外も含めた三井金属グループ従業員のマイパーパスを紹介しています。今後もパーパスに関する情報を発信していきます。



パーパス特設サイト  
(画像をクリックすると  
パーパス特設サイトに移動します)



## 薄型基板内蔵キャパシタ材料 「FaradFlex® (ファラドフレックス)」

### 各種情報通信機器の通信ノイズの低減に貢献

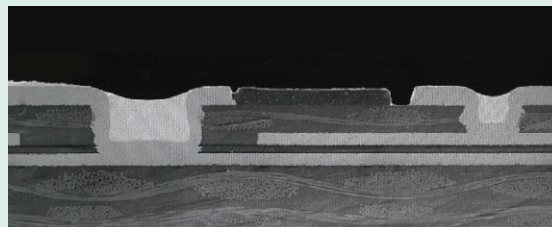
銅箔事業部のFaradFlex®は、各種情報通信機器の高速化・大容量化に向けて大きな課題である電源ノイズを低減するキャパシタ材料として、高性能のルーター・サーバー機器やスーパーコンピュータ

向けの高多層基板、スマートフォンに内蔵されるMEMSマイクロフォンなどに使用されており、キャリア付極薄銅箔MicroThin™に続く将来の成長事業と位置づけています。

#### ① FaradFlex®の構造

FaradFlex®は、3~25 $\mu\text{m}$ の極薄絶縁層を銅箔(厚さ18~70 $\mu\text{m}$ )でサンドイッチ状にした構造の材料。基板に内蔵されたFaradFlex®で、顧客希望容量のキャパシタ回路を形成します。

FaradFlex®を含む  
プリント配線板断面画像

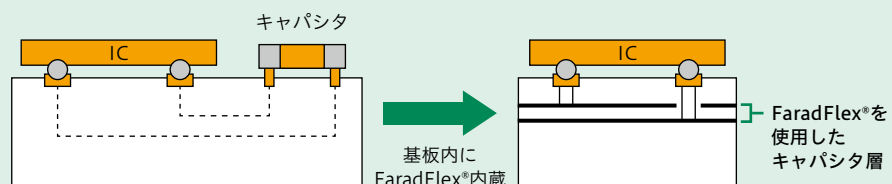


FaradFlex®  
(銅箔/絶縁層/銅箔の3層構造)

#### ② 基板内蔵キャパシタの使用イメージ

FaradFlex®を使用することで、ICの直下にキャパシタ層を形成することができ、ICとキャパシタ層の距離を縮めることで、電源ノイズを低減することができます。

FaradFlex®を含む  
プリント配線板断面図



### 生産能力増強およびBCP体制の構築

FaradFlex®は、足元5G化の進展や、スマートフォンおよびワイヤレスヘッドセットなどへの当社品採用率上昇に伴って需要が増加しており、今後も市場の成長が見込めることから、このたびFaradFlex®の生産拠点であるマレーシア工場(Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN.BHD.)で生産能力を増強しました。

加えて、上尾事業所にFaradFlex®の生産設備を新たに導入し、マレーシア工場と上尾事業所の2拠点で生産することでBCP体制を構築し、お客様に安心して使用していただける体制にします。



これにより、FaradFlex®はマレーシアおよび上尾の2拠点生産体制で、現在の約2.2倍の生産量となり、引き続きお客様への安定供給に努めていきます。

会社概要 (2022年9月30日現在)

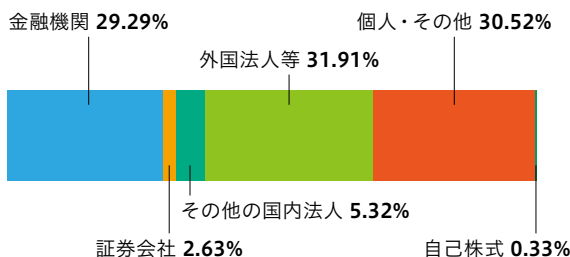
商号	<b>三井金属鉱業株式会社</b> (Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.) [呼称: 三井金属/MITSUI KINZOKU]
----	--

本店	東京都品川区大崎一丁目11番1号
設立	1950年5月1日
資本金	42,178百万円

株式の状況 (2022年9月30日現在)

発行可能株式総数	190,000,000株
発行済株式総数	57,329,098株
株主数	41,915名

所有者別株式分布状況



大株主(上位10名)

株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	10,641	18.62
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	3,491	6.11
JP MORGAN CHASE BANK 385632	1,389	2.43
三井金属社員持株会	1,300	2.27
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	891	1.56
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RELUDU RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT	772	1.35
三井金属取引先持株会	755	1.32
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	749	1.31
JP MORGAN CHASE BANK 385781	726	1.27
大樹生命保険株式会社	598	1.04

※ 持株比率は自己株式(191,484株)を控除して計算しております。  
※ 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

株主メモ

定時株主総会の議決権の基準日	3月31日
期末配当の基準日	3月31日
中間配当の基準日	9月30日
定時株主総会	6月下旬

株主名簿管理人・特別口座管理機関  
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  
三井住友信託銀行株式会社

ご連絡先  
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号  
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部  
☎ 0120-782-031  
株式に関するお手続き・よくある質問はこちら  
<https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency>

公告の方法

電子公告とする。(https://www.mitsui-kinzoku.com/toushi/stock\_info/denshikoukoku/)  
ただし、事故その他やむをえない事由によって電子公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。

〈株式事務のお取扱い〉

- 未払配当金の支払いのお申出先  
左記三井住友信託銀行にお申し出ください。
- 住所変更、単元未満株式買取等のお申出先  
① 証券会社の口座へ株式をお預けになられている株主様は、お取引のある証券会社にお申し出ください。  
② 証券会社の口座へ株式をお預けになられていない(特別口座に記録されている)株主様は、左記三井住友信託銀行にお申し出ください。

役員

取締役

納 武士  
代表取締役社長

木部 久和  
代表取締役専務取締役 兼  
専務執行役員/経営企画本部長

角田 賢  
専務取締役 兼 専務執行役員  
金属事業本部長

岡部 正人  
取締役 兼 常務執行役員  
機能材料事業本部長

宮地 誠  
取締役 兼 執行役員  
環境および安全衛生最高責任者

松永 守央  
社外取締役

戸井田 和彦  
社外取締役

武川 恵子  
社外取締役

監査役

沓内 哲  
常勤監査役

福本 浩敏  
常勤監査役

石田 徹  
社外監査役

井上 宏  
社外監査役

常務執行役員

井形 博史  
常務執行役員  
モビリティ事業本部長

山下 雅司  
常務執行役員  
経営企画本部 副本部長

執行役員

安田 清隆  
譚 耘

中山 恵造  
宮園 武志  
齋藤 修

杉元 晶子  
加藤 和照  
岡田 和之  
池信 省爾  
山本 拓也  
若井 健太郎  
落合 健司

フェロー

八島 勇

理事  
志岐 和也



三井金属鉱業株式会社

コーポレートコミュニケーション部  
〒141-8584 東京都品川区大崎一丁目11番1号  
TEL: 03-5437-8028

